

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2026-026

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 已结项的募投项目名称：盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“盛美半导体设备研发与制造中心”、“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“补充流动资金”和“高端半导体设备拓展研发项目”已完成投入或达到预定可使用状态，公司已于2025年6月将上述募投项目全部结项。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-047）。

● 为提高募集资金的使用效率，公司本次拟使用“盛美半导体设备研发与制造中心”项目节余募集资金8,356.73万元，以及首次公开发行股票剩余超募资金28,842.24万元（以上均截至2026年4月30日，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，其中拟使用的超募资金占超募资金总额的比例为16.85%。

● 本次使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金总额	368,523.90万元
募集资金净额	348,125.85万元
募集资金到账时间	2021年11月12日

二、本次募集资金节余情况及使用安排

截至2026年4月30日，已结项募投项目募集资金的使用及节余情况、使用安排如下：

单位：万元

结项名称	结项时间	调整后拟投入募集资金金额（A）	募集资金实际使用金额（B）	利息及理财收益扣除手续费净额（C）	节余募集资金金额（A-B+C）
盛美半导体设备研发与制造中心	2025年6月	144,500.00	137,988.27	1,845.00	8,356.73
盛美半导体高端半导体设备研发项目		45,000.00	45,458.74	458.74	0
补充流动资金		65,000.00	65,000.00	0	0
高端半导体设备拓展研发项目		73,087.15	74,434.75	1,347.60	0
节余募集资金合计金额		8,356.73万元			
节余募集资金使用用途及相应金额		<input checked="" type="checkbox"/> 补流，8,356.73万元			

注 1：募集资金实际使用金额包含募集资金存放期间产生的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益。

注 2：节余募集资金金额主要为已签订合同未支付募集资金，系未达到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等款项。

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

三、本次超募资金节余情况及使用安排

超募资金金额	171,141.07 万元
前次已使用金额	142,298.83 万元
本次使用用途及金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，28,842.24 万元

公司超募资金总额为 171,141.07 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 28,842.24 万元，占超募资金总额的比例为 16.85%。公司以往不存在使用超募资金永久补充流动资金的情形，最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺事项

截至本公告披露日，公司前次使用 249,999,701.17 元闲置募集资金临时补充流动资金已归还，相关内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日披露的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-020）。公司本次使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金事项将在经公司股东会审议通过后方可实施。

公司“盛美半导体设备研发与制造中心”项目已结项，但仍存在已签订合同但未达到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等款项，鉴于该等尚未支付款项支付周期较长，公司将在本次节余募集资金划转完毕后通过自有资金账户支付。本次使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

公司本次使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金，将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司长

远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合法律、法规、规范性文件的相关规定。

公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%；本次节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、适用的审议程序及保荐机构意见

（一）相关审议程序

公司于 2026 年 2026 年 5 月 26 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“盛美半导体设备研发与制造中心”项目节余募集资金 8,356.73 万元，以及首次公开发行股票剩余超募资金 28,842.24 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票超募资金系于《上市公司募集资金监管规则》生效前取得，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，相关超募资金使用仍适用《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条规定。公司本次使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年5月27日